



Samtec unterstützt SGeT oHFM.c mit leistungsfähigen Steckverbindungen

New Albany, Indiana (USA) – Samtec, Inc., der Anbieter mit führendem Service in der Steckverbinderbranche, stellt ein neues Produktportfolio für den Standard SGeT oHFM.c vor. Diese Steckverbinder basieren auf den bewährten Samtec-Produktfamilien [AcceleRate® HD](#) und [AcceleRate® HP](#) mit hohen Kontaktdichten und Übertragungsraten.



oHFM™, oder Open Harmonized FPGA Module, ist der weltweit erste offene, modulare FPGA Standard. Dank der vereinheitlichten, skalierbaren Architektur kann er Lösungen für die üblichen Herausforderungen anbieten, wenn es um besondere Anschlussbelegungen, kundenspezifische Formfaktoren und proprietäre Wärmeableitkonzepte im Rahmen der FPGA- und SOM-Entwicklung geht. Die gebrauchsfertigen Bausteine und klaren Gestaltungsregeln verringern die Entwicklungsdauer und verkürzen so die Zeit bis zur Marktreife.

Die Systems-on-Module (SOM) mit Steckverbinderanschluss (c = Connector) gemäß oHFM.c-Standard sind optimiert für Schnittstellen mit hohen Übertragungsraten, für FPGAs der mittleren bis oberen Leistungsklasse und für Upgrades bestehender Systeme mithilfe von Samtec-Steckverbindern mit 5 mm oder 10 mm Stapelhöhe.

Die oHFM.c-Steckverbinder von Samtec bieten bei einem Abstand von 0,635 mm eine hohe Kanaldichte mit Leistungszielen von 64 Gbit/s PAM4 bzw. 112 Gbit/s PAM4. Im Steckverbinder selbst sind die kurzen Seiten des Kontaktsystems Edge Rate® zum Steckverbinderkörper ausgerichtet, um die Kopplung über die lange Seite (Broadside Coupling) und das Übersprechen zu verringern und so die Signalintegrität zu optimieren. Das Edge Rate-Kontaktsystem weist darüber hinaus eine großflächig bearbeitete Kontaktfläche auf, die den Verschleiß verringert und die Langlebigkeit für Anwendungen mit hoher Steckzyklenzahl erhöht. Die IPC Klasse 3-konforme Lotsäulentechnik von Samtec für den Anschluss an die Leiterplatte sorgt für sicheren Halt der Steckverbinder auf der Leiterplatte. Der Anschluss per Lotsäule bietet eine äußerst zuverlässige Lötverbindung und exzellente Eigenschaften bei Einfügungs- und Rückflusdämpfung.

Die im Hinblick auf die stetig wachsenden Anforderungen an FPGA-basierte Computing-Plattformen ausgelegten Verbindungslösungen von Samtec ermöglichen skalierbare, flexible und zuverlässige Systemarchitekturen für kommende Embedded- und Edge-Anwendungen.

Informationen zur Bestellung und mehr

Die SGeT oHFM.c-konformen Steckverbinder von Samtec sind ab sofort ab Lager direkt von [Samtec](#) oder über unsere [autorisierten Vertriebspartner](#) erhältlich. Weitere Informationen zu den Verbindungslösungen von Samtec für SGeT oHFM.c-Anwendungen finden Sie auf samtec.com/oHFM.

Über Samtec

Das Unternehmen Samtec mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar ist ein weltweit tätiger Hersteller einer breit gefächerten Palette elektronischer Verbindungslösungen. Dazu gehören Hochgeschwindigkeits-B2B-Steckverbinder und -kabel, optische Mid-Board- und Panel-Einheiten, Flexible-Stacking-Lösungen, robuste Bauelemente und Kabel im Mikroformat sowie präzise HF-Technik. Die globale Präsenz von Samtec an über 40 internationalen Standorten mit einem Produktverkauf in mehr als 125 Ländern macht den unerreichten Kundendienst des Unternehmens möglich. Samtec stellt hochwertige Verbindungslösungen für kommende Anforderungen der Branchen IKT, Industrie, Militär/Luft- und Raumfahrt, Medizin, Computer, Halbleiter, Leittechnik, Automotive und andere bereit. Weiterführende Informationen finden Sie auf <http://www.samtec.com>.

Über SGeT

SGeT.org

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Telefon: +1 812-944-6733
www.samtec.com/media-room

Unser Presseteam stellt Medienschaffenden weltweit sehr gerne spannende und innovative Storys zur Verfügung. Sollten Sie ein Mitglied der Medien/Presse sein und ein Gespräch mit uns wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an mediaroom@samtec.com.